



平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年2月14日

上場会社名 株式会社RS Technologies 上場取引所 東  
 コード番号 3445 URL http://www.rs-tec.jp  
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)方 永義  
 問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)鈴木 正行 (TEL) 03(5709)7685  
 定時株主総会開催予定日 平成29年3月29日 配当支払開始予定日 平成29年3月30日  
 有価証券報告書提出予定日 平成29年3月29日  
 決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年12月期の連結業績(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年12月期	8,849	59.6	1,557	44.1	1,450	54.7	869	185.8
27年12月期	5,545	21.4	1,081	△7.3	937	△24.8	304	△54.2

(注) 包括利益 28年12月期 862百万円(202.8%) 27年12月期 284百万円(△59.0%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
28年12月期	159.97	155.14	28.2	14.1	17.6
27年12月期	56.72	55.04	14.6	11.3	19.5

(参考) 持分法投資損益 28年12月期 -百万円 27年12月期 -百万円

(注) 当社は、平成27年3月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、平成27年12月期会計年度の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、新規上場日から平成27年12月期会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
28年12月期	10,859	3,541	32.6	642.59
27年12月期	9,737	2,644	27.1	485.54

(参考) 自己資本 28年12月期 3,535百万円 27年12月期 2,638百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
28年12月期	964	△776	△91	1,714
27年12月期	470	△2,127	2,327	1,603

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
27年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
28年12月期	—	0.00	—	10.00	10.00	55	6.3	1.8
29年12月期(予想)	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 1. 28年12月期期末配当金の内訳 普通配当5円00銭 記念配当5円00銭  
 2. 29年12月期の配当は未定です。

3. 平成29年12月期の連結業績予想(平成29年1月1日～平成29年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	4,232	9.1	977	93.0	908	481.7	586	792.2	107.76
通期	8,556	△3.3	1,939	24.5	1,825	25.8	1,177	35.4	216.49

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有  
 ② ①以外の会計方針の変更： 無  
 ③ 会計上の見積りの変更： 無  
 ④ 修正再表示： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	28年12月期	5,505,000株	27年12月期	5,440,000株
② 期末自己株式数	28年12月期	3,407株	27年12月期	6,700株
③ 期中平均株式数	28年12月期	5,436,393株	27年12月期	5,364,251株

(注) 自己株式数は、「従業員持株E S O P信託口」が保有する当社株式（28年12月期：3,300株、27年12月期：6,700株）を期末自己株式数に含めて記載しております。また、「従業員持株E S O P信託口」が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。（28年12月期：4,902株、27年12月期：2,516株）

(参考) 個別業績の概要

1. 平成28年12月期の個別業績（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年12月期	7,817	35.9	1,597	12.1	1,564	14.7	920	14.9
27年12月期	5,752	26.0	1,425	19.8	1,364	5.4	801	12.8
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円 銭		円 銭					
28年12月期	169.37		164.26					
27年12月期	149.35		144.92					

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	円 銭	百万円	円 銭	%		円 銭	
28年12月期	9,652		4,138		42.8		751.07	
27年12月期	7,896		3,182		40.2		584.68	

(参考) 自己資本 28年12月期 4,132百万円 27年12月期 3,176百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析2.次期の見通し」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 経営成績・財政状態に関する分析	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	3
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
(4) 事業等のリスク	4
2. 経営方針	7
(1) 会社の経営の基本方針	7
(2) 目標とする経営指標	7
(3) 中長期的な会社の経営戦略	7
(4) 会社の対処すべき課題	7
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	8
4. 連結財務諸表	9
(1) 連結貸借対照表	9
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	11
(3) 連結株主資本等変動計算書	13
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	14
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	15
(継続企業の前提に関する注記)	15
(会計方針の変更)	15
(表示方法の変更)	15
(追加情報)	15
(セグメント情報等)	16
(1株当たり情報)	18
(重要な後発事象)	18

## 1. 経営成績・財政状態に関する分析

### (1) 経営成績に関する分析

#### ①当期の経営成績

当連結会計年度における世界経済は、米国経済が緩やかに回復してきたものの、中国及び新興国における景気減速、英国のEU離脱問題、米国の次期大統領選挙の結果などから、不透明感が増大しました。

一方、国内においては、年初からの円高、為替相場の急激な変動、日銀によるマイナス金利の導入等の影響はありましたが、企業収益の回復や雇用情勢の改善が続き、景気は、不透明な要因を含みながらも、底堅く推移しました。

当社グループを取り巻く事業環境は、半導体メモリー業界の好調に加え、第4四半期に入り、ファンドリー各社の稼働率も上昇してきました。第2四半期以降の300mmウェーハ需要の拡大が第4四半期以降も継続し、また200mmウェーハの需要も増加し、300mm・200mm共、ウェーハ需要の逼迫が顕在化してきました。そのような環境の中、ウェーハ事業も順調に入荷が拡大し、当社グループ台湾工場は第4四半期からフル生産体制に入りました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は8,849,546千円（前年同期比59.6%増）となりました。営業利益は1,557,630千円（前年同期比44.1%増）となり、経常利益は1,450,696千円（前年同期比54.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は869,652千円（前年同期比185.8%増）となりました。

事業のセグメント別の業績を示すと次のとおりです。

なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分について、「半導体生産設備の買取・販売」に係る売上高が事業拡大に伴い10%以上になったことにより「ウェーハ事業」「半導体生産設備の買取・販売」の2区分に変更しております。前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

#### (ウェーハ事業)

ウェーハ事業におきましては、再生市場の需要が堅調に推移したことなどから売上高は7,144,349千円（前年同期比39.9%増）、セグメント利益（営業利益）は1,718,489千円（前年同期比24.0%増）となりました。

#### (半導体生産設備の買取・販売事業)

半導体生産設備の買取・販売におきましては、消耗材の液晶モジュール等の販売増加により売上高は1,611,627千円（前年同期比931.0%増）、セグメント利益（営業利益）221,512千円（前年同期比63.6%増）となりました。

#### (その他)

その他におきましては、ソーラー事業、半導体の関連材料販売及び技術コンサルティングの業績を示しており、外部顧客への売上高は93,568千円（前年同期比66.8%減）、セグメント利益（営業利益）は66,610千円（前年同期比129.3%増）となりました。

なお、当社株式は平成28年9月9日にて、東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部に市場変更されました。今後は更なる業容の拡大と企業価値の向上を目指してまいります。

#### ②次期の見通し

当社グループは、三本木工場のフル稼働に加え、国内工場で培ってきた生産技術と生産方法による台湾工場の本格稼働により、国内・海外のシリコンウェーハ再生事業の更なる拡大を目指して参ります。また、国内・海外において、半導体関連商品の販売にも一層注力して参ります。

次期（平成29年12月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高8,556百万円（前年同期比3.3%減）、営業利益1,939百万円（前期比24.5%増）、経常利益1,825百万円（前期比25.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,177百万円（前期比35.4%増）を見込んでおります。

## (2) 財政状態に関する分析

(資産、負債及び純資産の状況)

(資産の部)

当連結会計年度末における流動資産は5,525,586千円となり、前連結会計年度末と比較して1,632,958千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金110,405千円、受取手形及び売掛金1,757,057千円の増加及び繰延税金資産251,947千円の減少によるものであります。

固定資産は5,333,614千円となり、前連結会計年度末と比較して511,495千円減少いたしました。これは主に有形固定資産515,449千円の減少によるものであります。

この結果、総資産は10,859,200千円となり、前連結会計年度末に比べて1,121,463千円増加いたしました。

(負債の部)

当連結会計年度末における流動負債は3,000,339千円となり、前連結会計年度末と比較して704,725千円増加いたしました。これは主に、短期借入金227,500千円、1年内返済予定の長期借入金83,870千円、未払法人税等417,873千円の増加によるものであります。

固定負債は4,317,570千円となり、前連結会計年度末と比較して480,431千円減少いたしました。これは主に、長期借入金459,316千円の減少によるものであります。

この結果、負債合計は7,317,910千円となり、前連結会計年度末に比べ224,294千円増加いたしました。

(純資産の部)

当連結会計年度末における純資産は3,541,290千円となり、前連結会計年度末と比較して897,168千円増加いたしました。これは主に、資本金13,000千円、資本剰余金13,000千円、利益剰余金869,652千円の増加によるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、32.6%（前連結会計年度末は27.1%）となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結会計年度末の1,603,704千円より110,548千円増加し、残高は1,714,252千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

## ①営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、964,180千円（前連結会計年度は470,273千円の増加）となりました。

主な増加要因は、税金等調整前当期純利益1,454,501千円、減価償却費682,158千円の計上及び未払金の増加112,211千円によるものであります。また主な減少要因は売上債権の増加1,737,000千円によるものであります。

## ②投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、776,264千円（前連結会計年度は2,127,740千円の減少）となりました。

主な減少要因は、シリコンウェーハ製造設備及び研究開発設備等に伴う有形固定資産の取得による支出759,716千円、敷金及び保証金の差入による支出18,463千円によるものであります。

## ③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、91,211千円（前連結会計年度は2,327,368千円の増加）となりました。

主な増加要因は、短期借入金の純増額223,176千円及び長期借入れによる収入500,000千円によるものであります。また主な減少要因は、長期借入金の返済による支出871,410千円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成27年12月期	平成28年12月期
自己資本比率(%)	27.1	32.6
時価ベースの自己資本比率(%)	119.4	203.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	11.3	5.4
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	5.8	13.1

自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注2) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

(注5) 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

### (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

平成27年度までは、継続して設備投資を実施して行く必要があったことから、内部留保を確保しつつ、配当は実施せず、資金の確保を優先しておりました。一方で、株主に対する利益の還元は、当社にとって最も重要な経営の課題として認識しており、配当に関しては、各事業年度における利益水準、中期計画の見通し、財務体質の強化等の状況を総合的に勘案した上で、柔軟に実施していく方針であります。

上記方針に基づき、当期の配当につきましては、定時株主総会における決議を前提として、普通株式1株につき10円（普通配当5円、記念配当5円）となる予定です。

また、次期の配当につきましては、現時点では未定であります。

### (4) 事業等のリスク

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものでない点に留意する必要があります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 特定の取引先への依存に関するリスク

当社グループは、世界有数の半導体受託生産企業であるTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSMC)との円滑な取引を継続しており、同社に対する売上高が当社グループの売上高に占める割合は、前連結会計年度26.6%、当連結会計年度20.6%と高い割合となっております。

従って、同社の販売及び設備投資の動向によっては当社グループの短期的な経営成績に影響を与える可能性があります。

#### (2) 業界動向に関するリスク

当社グループの主な需要先は半導体業界であります。需給の変動があった場合、シリコンウェーハの使用量の減少や販売価格の低下により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

## (3) 他社との競合に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場は、国内外を問わず厳しい競合環境にあり、同業他社との間では価格、品質、顧客対応能力、新製品開発力等、様々な局面での競争が展開されています。

当社グループは、ウェーハ事業において高い価格競争力を有する様々なテスト用半導体ウェーハを手掛けることにより、収益源を確保すると共に半導体需給や技術動向の把握及び顧客層や製品分野の拡大を図っていますが、高シェア製品の市場支配力が低下することにより競争上の地位が低下した場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## (4) 外注先の品質管理に関するリスク

当社グループは、ウェーハ事業の加工工程を外部企業に一部委託しています。当社グループでは、委託先企業の経営状況、技術水準、製造能力について継続的に監視していますが、委託先企業が、必要な技術的・経済的資源を維持するとともに十分な製品の品質を保ち、当社グループが求める水準の委託業務を遂行できる保証はありません。

また、これらの委託先において何らかの理由により事業が中断された場合、当社グループ製品の加工及び製品の供給に影響を及ぼす可能性があります。

## (5) 加工工程に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場では、製品価格が継続的に低下する傾向にあります。当社グループでは、生産プロセスの見直し等により生産効率の向上を進め、製品価格低下の影響を緩和するように努めていますが、一般的に生産効率の向上には限界があるため、製品価格の低下が続き、かつ、継続的に生産効率を向上させることができなくなった場合、利益が圧迫される可能性があります。さらに、加工工程において、何らかの理由により加工活動が中断してしまった場合、生産能力低下や納期遅延が発生し、ウェーハの供給が困難となる可能性があります。当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。

## (6) 設備投資及び資金調達に関するリスク

当社グループは、市場動向、需要動向等を見極めながら、事業戦略及び当該投資の収益性等を勘案しつつ必要な設備投資を実施していく方針です。

大規模な設備投資を行った場合、製造ラインの調整等を行う必要があることから、本格的な生産に至るまでには一定の期間を要するため、製造設備の新設・増設に伴う立上げ費用や減価償却費が先行的に発生することになります。また、多額の設備投資を実施した場合、減価償却費等が大幅に増加する可能性があります。

これらの要因により、今後当社グループの利益率が大幅に悪化する可能性があります。また、当該設備投資を行う際に想定していた受注を期待通りに獲得できなかった場合には、当社グループの経営成績等は重大な影響を受ける可能性があります。

また、当社グループは、事業展開の必要に応じて機動的な資金調達を実施していく方針ですが、当該資金調達に際しては、当社グループの財政状態、収益性等のほか、金利水準や市場環境等の要因により、当社グループが希望する時期または条件により資金調達を実行できない場合があり、そのような場合には、必要な設備投資を行うことができず、事業計画等において想定していた収益を上げられない可能性があります。当社グループの事業、経営成績及び財政状態に重大な影響を与えるリスクがあります。

## (7) 為替の変動に関するリスク

当社グループの海外売上高比率は、前連結会計年度62.7%、当連結会計年度60.7%と高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産及び負債の評価は為替相場の変動により影響を受けております。このため、為替相場の急激な変動によっては当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

## (8) 特定人物への依存に関するリスク

現在、当社グループの経営は代表取締役社長である方永義を含めた8名の取締役と3名の監査役で構成される経営陣で運営されており、代表取締役社長である方永義個人に依存した組織ではありません。しかしながら、同氏は、前職(株式会社永輝商事代表取締役)までの経営者としての経験・人脈を生かし、当社グループの新規営業先の開拓、グローバルな事業展開において重要な役割を果たしております。同氏への依存を軽減するための経営構造の変革過程で、何らかの理由により同氏の業務遂行が困難となった場合には、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(9) 事故、災害等による操業への影響に関するリスク

当社グループの生産設備の中には、ウェーハ事業の炉など高温、高圧での操業を行なっている設備があります。また、ウェーハを加工するうえで多量の化学薬品等を取り扱っています。対人・対物を問わず、事故の防止対策には万全を期しておりますが、万一重大な事故が発生した場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。また、国内外の製造拠点等において、大規模地震や台風等の自然災害、新型インフルエンザ等の感染症、その他当社グループの制御不能な事態により操業に支障が生じた場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。

(10) 財務制限条項に関するリスク

当社は、事業に必要な資金調達のため、平成26年3月に金融機関との間でコミットメント期間付タームローン及びシンジケートローン契約を締結しており、これらの借入契約には、純資産の維持及び経常利益の確保に関して財務制限条項が付加されております。今後、当社グループの経営成績が著しく悪化するなどして財務制限条項に抵触した場合、借入先金融機関の請求により当該借入について期限の利益を喪失し、一括返済を求められるなどして、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 有利子負債への依存及び金利水準の動向に関するリスク

当社グループは、主に金融機関からの借入金によって事業資金を調達しており、総資産に占める有利子負債の割合は、当連結会計年度において47.9%であります。当社グループでは、金利等の動向を注視しつつ、将来の環境変化にも柔軟な対応が可能な調達形態の維持・構築に努めております。しかしながら、事業の規模拡大に伴う資金需要により、有利子負債の割合が上昇するとともに、金利水準の上昇により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する」ことを経営の基本理念とし、「多様性を尊重し、自由闊達な企業風土をつくり、「就業環境No.1」を目指す」「エコロジー事業を通して環境に優しい総合エコソリューション企業として世界をリードし、人々の豊かな生活に貢献する」「公正、信用を重視し、社会を利する事業を進める」ことを行動指針としております。当社は、この経営の基本理念及び行動指針に従い、社会的な責任を遂行し企業価値を最大化することを経営方針としております。

### (2) 目標とする経営指標

当社グループは、更なる成長を続けることにより企業価値の最大化を図るため、売上高、売上高営業利益率、1株当たり当期純利益、ROE（自己資本利益率）、ROA（総資本利益率）を重要な経営指標としております。

### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループの事業は半導体市場と相関がありますが、半導体デバイスは、パソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機、デジタル家電へと急速に広がり、そうした機器の需要は世界的に拡大しております。

今後も、世界人口の増加と新興国の経済発展に伴う需要、及び先進国の更なるデバイス用途（ロボットの多様化・自動車・家・街・IoT…等）の広がりにより、半導体需要の増加が継続することが予測されております。半導体需要の増加に伴い、その基盤となるシリコンウェーハもまた需要が拡大し、再生需要も増加が予測されております。

現在、顧客需要に対し供給不足になる傾向にあります。将来的には、三本木工場及び台湾工場の増設等に伴う大規模な設備投資により、生産力を増強します。三本木工場に導入済である新規設備には、次世代の18インチ（450mm）ウェーハの加工装置も含まれており、需要が顕在化した際には、世界に先駆けて製造を行う予定であります。

また、シリコンウェーハ再生事業の強化等を目的として、平成28年5月に日本バルカー工業株式会社と資本業務提携を行うことで合意しました。今後も、国内外企業との業務提携やM&A等の手法を用いて、再生市場における当社の更なるシェア拡大を目指します。

（長期的には、増設・新設後の工場をフル稼働し、再生市場でのシェア拡大を目指します。）

### (4) 会社の対処すべき課題

当社グループの主要な事業であるシリコンウェーハ再生事業は、半導体市場の影響を受けます。足許において、世界の長期的な半導体需要は増加傾向にあり、半導体メーカーからの需要も増加しております。このような中、当社グループとしては国内国外を問わず半導体メーカーの需要を取り込む必要があります。また、日々進歩している微細化技術の開発や18インチ（450mm）ウェーハの開発等の技術革新にも対応していく必要があります。当社グループはこのような経営環境の中で以下の事項を対処すべき課題として認識しております。

#### ① 技術開発

- a. 世界最先端の微細化技術に適應する12インチ（300mm）ハイエンド向け再生技術を開発、事業化すること。
- b. 18インチ（450mm）ウェーハの再生技術を開発、事業化すること。

#### ② 営業施策

- a. アメリカ・欧州・台湾・シンガポール・中国・韓国をはじめとする海外との取引を更に強化すること。
- b. 大手半導体デバイスメーカーとの安定的取引を確保すること。
- c. モニタウェーハ及びターゲット材（※）・ケミカル消耗品の販売を強化すること。
- d. 半導体関連商品の販売を強化すること。

#### ③ 製造体制

- a. 半導体デバイスの高集積度化に対応すること。
- b. 最先端設備を拡充すること。
- c. 高度な知識・技能を有する人材を確保すること。

#### ④ 海外進出

- a. 主要な半導体メーカーの需要に適時に対応するため海外進出をすること。

※ターゲット材 半導体を加工する時の補助材料

### 3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

## 4. 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,842,523	1,952,928
受取手形及び売掛金	970,873	2,727,931
商品及び製品	346,599	361,110
仕掛品	123,123	132,598
原材料及び貯蔵品	146,355	134,801
繰延税金資産	379,022	127,075
その他	84,129	92,401
貸倒引当金	—	△3,261
流動資産合計	3,892,627	5,525,586
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,524,855	1,525,555
減価償却累計額	△19,101	△100,888
建物及び構築物 (純額)	1,505,754	1,424,667
機械装置及び運搬具	4,196,335	4,795,490
減価償却累計額	△588,815	△1,182,784
機械装置及び運搬具 (純額)	3,607,520	3,612,706
工具、器具及び備品	82,437	86,231
減価償却累計額	△8,482	△30,490
工具、器具及び備品 (純額)	73,954	55,741
リース資産	—	60,613
減価償却累計額	—	△2,020
リース資産 (純額)	—	58,593
建設仮勘定	480,434	506
有形固定資産合計	5,667,664	5,152,215
無形固定資産		
ソフトウェア	29,136	23,050
無形固定資産合計	29,136	23,050
投資その他の資産		
破産更生債権等	—	6,831
その他	148,308	158,348
貸倒引当金	—	△6,831
投資その他の資産合計	148,308	158,348
固定資産合計	5,845,109	5,333,614
資産合計	9,737,737	10,859,200

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	186,167	283,389
短期借入金	353,000	580,500
1年内返済予定の長期借入金	863,295	947,166
リース債務	—	10,659
未払金	732,078	310,223
未払法人税等	8,949	426,823
賞与引当金	22,311	20,659
株主優待引当金	—	13,797
その他	129,810	407,119
流動負債合計	2,295,613	3,000,339
固定負債		
長期借入金	4,079,442	3,620,126
リース債務	—	42,332
繰延税金負債	717,086	643,648
その他	1,472	11,463
固定負債合計	4,798,001	4,317,570
負債合計	7,093,615	7,317,910
純資産の部		
株主資本		
資本金	616,450	629,450
資本剰余金	616,440	629,440
利益剰余金	1,418,257	2,287,910
自己株式	△17,094	△8,550
株主資本合計	2,634,052	3,538,249
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	4,055	△2,972
その他の包括利益累計額合計	4,055	△2,972
新株予約権	6,013	6,013
純資産合計	2,644,121	3,541,290
負債純資産合計	9,737,737	10,859,200

## (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

## 連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
売上高	5,545,500	8,849,546
売上原価	3,673,492	6,332,983
売上総利益	1,872,007	2,516,562
販売費及び一般管理費	790,698	958,931
営業利益	1,081,308	1,557,630
営業外収益		
受取利息	1,012	901
補助金収入	19,563	117,213
その他	11,742	14,115
営業外収益合計	32,317	132,230
営業外費用		
支払利息	85,956	74,745
為替差損	53,135	127,054
株式公開費用	14,292	24,688
その他	22,375	12,676
営業外費用合計	175,760	239,164
経常利益	937,865	1,450,696
特別利益		
国庫補助金収入	2,443,047	14,776
特別利益合計	2,443,047	14,776
特別損失		
設備移設費用	249,040	—
固定資産除却損	—	1,256
固定資産圧縮損	2,443,047	9,715
特別損失合計	2,692,087	10,971
税金等調整前当期純利益	688,825	1,454,501
法人税、住民税及び事業税	4,404	399,518
法人税等調整額	380,171	185,329
法人税等合計	384,576	584,848
当期純利益	304,248	869,652
親会社株主に帰属する当期純利益	304,248	869,652

## 連結包括利益計算書

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
当期純利益	304,248	869,652
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△19,400	△7,028
その他の包括利益合計	△19,400	△7,028
包括利益	284,848	862,624
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	284,848	862,624
非支配株主に係る包括利益	—	—

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額		新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	199,000	198,990	1,114,008	—	1,511,998	23,776	23,776	—	60,320	1,596,094
当期変動額										
新株の発行	417,450	417,450			834,900					834,900
自己株式の取得				△19,901	△19,901					△19,901
自己株式の処分				2,806	2,806					2,806
親会社株主に帰属する当期純利益			304,248		304,248					304,248
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						△19,720	△19,720	6,013	△60,320	△74,027
当期変動額合計	417,450	417,450	304,248	△17,094	1,122,054	△19,720	△19,720	6,013	△60,320	1,048,026
当期末残高	616,450	616,440	1,418,257	△17,094	2,634,052	4,055	4,055	6,013	—	2,644,121

当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額		新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	616,450	616,440	1,418,257	△17,094	2,634,052	4,055	4,055	6,013	—	2,644,121
当期変動額										
新株の発行	13,000	13,000			26,000					26,000
自己株式の取得				△130	△130					△130
自己株式の処分				8,674	8,674					8,674
親会社株主に帰属する当期純利益			869,652		869,652					869,652
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						△7,028	△7,028	—	—	△7,028
当期変動額合計	13,000	13,000	869,652	8,544	904,196	△7,028	△7,028	—	—	897,168
当期末残高	629,450	629,440	2,287,910	△8,550	3,538,249	△2,972	△2,972	6,013	—	3,541,290

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	688,825	1,454,501
減価償却費	326,319	682,158
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	10,092
賞与引当金の増減額 (△は減少)	11,146	△1,318
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	—	13,797
受取利息及び受取配当金	△1,012	△901
補助金収入	△19,563	△117,213
国庫補助金収入	△2,443,047	△14,776
為替差損益 (△は益)	56,746	19,442
支払利息	85,956	74,745
株式公開費用	14,292	24,688
固定資産圧縮損	2,443,047	9,715
売上債権の増減額 (△は増加)	△279,691	△1,737,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△217,857	△11,175
仕入債務の増減額 (△は減少)	35,395	92,733
未払金の増減額 (△は減少)	15,058	112,211
その他	△41,544	312,210
小計	674,072	923,911
利息及び配当金の受取額	1,087	792
補助金の受取額	19,563	116,017
利息の支払額	△80,503	△73,849
法人税等の支払額	△143,946	△2,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	470,273	964,180
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△4,537,635	△759,716
無形固定資産の取得による支出	△15,025	△5,430
貸付金の回収による収入	1,917	—
敷金及び保証金の差入による支出	△8,441	△18,463
敷金及び保証金の回収による収入	—	1,192
保険積立金の積立による支出	△7,219	△7,219
国庫補助金の受取額	2,443,047	14,776
その他	△4,383	△1,404
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,127,740	△776,264
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△124,680	223,176
長期借入れによる収入	4,924,027	500,000
長期借入金の返済による支出	△3,271,637	△871,410
株式の発行による収入	814,852	25,946
自己株式の取得による支出	△19,901	△130
自己株式の売却による収入	2,589	8,674
セール・アンド・リースバックによる収入	—	60,085
リース債務の返済による支出	—	△2,864
その他	2,116	△34,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,327,368	△91,211
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17,224	13,844
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	652,676	110,548
現金及び現金同等物の期首残高	951,027	1,603,704
現金及び現金同等物の期末残高	1,603,704	1,714,252

## (5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については連結財務諸表の組替えを行っております。

(表示方法の変更)

連結損益計算書

前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「株式公開費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた36,668千円は、「株式公開費用」14,292千円、「その他」22,375千円として組み替えております。

連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収消費税等の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収消費税等の増減額(△は増加)」に表示していた△18,360千円、「その他」△23,184千円は、「その他」△41,544千円として組替えしております。

(追加情報)

(法定実効税率の変更等による影響)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.0%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度から平成30年1月1日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産は3,597千円減少、繰延税金負債は32,843千円減少、法人税等調整額は29,246千円減少しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

## 1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、報告セグメントを「ウェーハ事業」と「半導体生産設備の買取・販売」の2事業としております。「ウェーハ事業」は、半導体用シリコンウェーハの再生、加工及び販売を行っております。「半導体の関連材料販売」は、主に中古の半導体関連機械装置（新品及び半導体以外も可）、消耗材を対象とするもので、主に中国市場へ販売を行っております。なお、当連結会計年度より投資事業を始めておりますが、立上げ段階のため、売上及び利益は計上していません。

当社グループは、当連結会計年度より、半導体生産設備の買取・販売に係る売上が事業拡大に伴い報告セグメント売上高の合計金額の10%を超えたため、半導体生産設備の買取・販売を報告セグメントとして区分表示する方法に変更しております。

これにより、当連結会計年度の報告セグメントにおいて、「半導体生産設備の買取・販売」の売上高1,611,627千円、セグメント利益221,512千円を記載しており、「その他」が同額減少しております。

また、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しており、「3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載しております。

## 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

## 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ウェーハ事業	半導体生産設備 の買取・販売	計				
売上高							
外部顧客への売上高	5,107,008	156,324	5,263,333	282,166	5,545,500	—	5,545,500
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	216,580	216,580	—	216,580	△216,580	—
計	5,107,008	372,905	5,479,913	282,166	5,762,080	△216,580	5,545,500
セグメント利益	1,386,332	135,389	1,521,721	29,046	1,550,767	△469,459	1,081,308
セグメント資産	6,993,213	42,062	7,035,276	533,090	7,568,366	2,169,371	9,737,737
その他の項目							
減価償却費	306,459	—	306,459	15,597	322,056	4,262	326,319
減損損失	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	4,515,369	—	4,515,369	149,728	4,665,097	225	4,665,322

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業、半導体の関連材料販売と技術コンサルティングであります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△469,459千円にはセグメント間取引消去△116,094千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△353,364千円が含まれております。

(2)セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。

全社資産は主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3)減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る増加額であります。

3.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4.セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。

当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ウェーハ事業	半導体生産設備 の買取・販売	計				
売上高							
外部顧客への売上高	7,144,349	1,611,627	8,755,977	93,568	8,849,546	—	8,849,546
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	7,144,349	1,611,627	8,755,977	93,568	8,849,546	—	8,849,546
セグメント利益	1,718,489	221,512	1,940,001	66,610	2,006,612	△448,981	1,557,630
セグメント資産	5,620,119	1,132,912	6,753,031	556,242	7,309,273	3,549,926	10,859,200
その他の項目							
減価償却費	654,918	—	654,918	22,823	677,742	4,416	682,158
減損損失	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	201,817	—	201,817	—	201,817	7,252	209,069

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業、半導体の関連材料販売と技術コンサルティングであります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

(1)セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。

(2)セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。

全社資産は主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3)減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る増加額であります。

3.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## (1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
1株当たり純資産額	485円54銭	642円59銭
1株当たり当期純利益金額	56円72銭	159円97銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	55円04銭	155円14銭

- (注) 1. 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の株式数については、従業員持株ESOP信託が所有する自己株式3,300数(前連結会計年度末6,700株)を控除し算定しております。
2. 1株当たり当期純利益の算定に用いられた期中平均株式数については、従業員持株ESOP信託が所有する自己株式数4,902株(前連結会計年度2,516株)を控除し算定しております。
3. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	304,248	869,652
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	304,248	869,652
普通株式の期中平均株式数(株)	5,364,251	5,436,393
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	163,986	169,259
(うち新株予約権(株))	163,986	169,259
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	第2回新株予約権 平成27年6月19日決議 100,000株 第3回新株予約権 平成27年6月19日決議 153,000株	第3回新株予約権 平成27年6月19日決議 132,000株

(注) 当社株式は、平成27年3月24日をもって、東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新規上場日から前連結会計年度までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。